

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：景文科技大學

發文日期：中華民國114年6月16日

發文字號：北科大產學字第1147900178號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：114年半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫課程表、114年半導體IC晶片
封裝製程技術菁英人才培育計畫海報（114F900541_1_16102312877.pdf、
114F900541_2_16102312877.pdf）

主旨：檢送本校與明新科技大學半導體學院合作辦理114年「半
導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程資訊
（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公
告，請查照。

說明：

- 一、本課程旨在培育具備產業即戰力的半導體技術人才，內容
涵蓋台灣在全球半導體產業中的戰略地位、產業鏈介紹、
技術趨勢解析，以及半導體在日常生活中的應用等理論基
礎；實作課程的部分，學員將親自操作晶圓切割機、打線
機、黏晶機等封裝設備，並進行功率IC測試設備操作訓
練，包括晶圓針測試機與高功率元件測試機等，深入了解
2D/3D封裝、WLP與PLP等先進製程技術。透過理論與實務並
重的安排，幫助學生建立完整的半導體封測技術知識體
系，奠定相關職能基礎。

- 二、報名資格：國內各公私立大專校院之在學學生。



三、課程時間：114年7月17日（四）、114年7月18日（五）共計2天，凡符合報名資格且參與全程課程者，於課程結束後擇期核發研習時數證明電子檔。

四、課程地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路1號）。

五、人數上限：實體30人（無線上課程）。

六、報名時間：即日起至114年7月14日（一）17:00為止（如人數額滿將提前截止）。

七、報名網址：<https://forms.gle/jXWh6J3RfEPsDRav9>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw

九、本課程與美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司合作辦理。

十、檢附114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、明新學校財團法人明新科技大學半導體學院、美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司

